

热传导胶带

热传导胶带广泛应用在 CPU、功率管、模块电源等发热器件的热传导设计中，它能够完全替代传统硅脂的应用场合，高效便捷的传递热量。导热胶带以高导热橡胶为导热基材，单面或双面背有压敏导热胶，粘接可靠、强度高。导热胶带厚度薄，柔韧性好，非常易于贴合器件和散热器表面。导热胶带还能适应冷、热温度的变化，保证性能的一致和稳定。

导热胶带的压敏背胶有高粘接强度和优异导热性能，可以将器件和散热器粘接固定，实现导热、绝缘和固定，特别适合于集成度高、设备空间小、固定困难等场合，是减小散热附件占用体积，优化设计的适用材料。

性能参数

指标	T404	BP105	BP108	T412
热阻 $^{\circ}\text{C}\text{-in}^2/\text{w}$	0.6	0.3	0.5	0.25
耐压 (VAC)	5000	3000	6500	----
剪切强度	130 (PSI)	100 (PSI)	100 (PSI)	135 (PSI)
温度范围	-40~150 $^{\circ}\text{C}$	-30~120 $^{\circ}\text{C}$	-30~120 $^{\circ}\text{C}$	-40~150 $^{\circ}\text{C}$
厚度	0.127mm	0.13mm	0.2mm	0.229mm
尺寸 (幅宽)	152mm	305mm	305mm	152mm

使用方法

导热双背面胶带在粘接时要注意操作方法，严禁用手或其他非粘接物接触表面，严禁反复揭贴，被粘接面应保持干净、干燥，一般在使用前用酒精清洗，以避免影响粘接牢固性。辅助用品：棉布、工业清洁剂、橡胶手套。

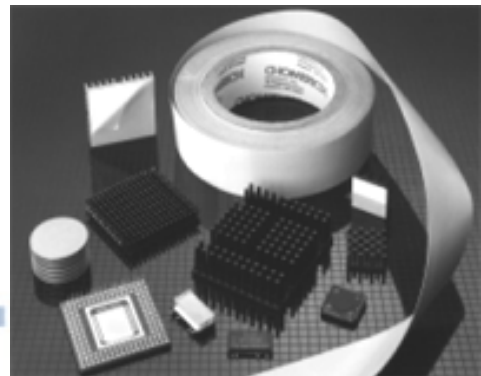
第一步：用不脱毛棉布擦干净器件表面。

第二步：用浸过工业清洁剂的棉布擦干净器件表面，去油污；另外安装过程不要再接触清洁表面。

第三步：撕下其中一面背胶上的保护膜，手指不要触及胶面。

第四步：将其贴在器件表面，从粘接面积中心向四周用力轻压五秒，保证双背面胶带与散热器件表面完全 100%接触。

第五步：撕掉另一面背胶上的保护膜按第三、四步同样方法，使双背面胶带与芯片粘界牢固。



地址：北京市海淀区阜成路 14 号 3 号楼 218 室 (100037)

TEL: +86-10-68371075/68371012 /68371747/68371561 FAX: +86-10- 68768863

网址: www.reintech.cn E-mail: reintech@163.com